

目次

	<頁>		<頁>
第1章 半導体パッケージの種類と使用例	4	第5章 BGAの組立工程	143
第2章 半導体パッケージの役割	30	ワイヤBGAの組立工程	144
第3章 半導体の組立とは何か	34	基板製造方法	145
第4章 QFPの組立工程	52	FCBGAの組立工程	151
バックグラインディング工程	55	第6章 セラミックパッケージの組立工程	155
ダイシング工程	59	第7章 TCPの組立工程	161
ダイボンディング工程	72	第8章 WSPの組立工程	164
リードフレーム製造方法	79	第9章 テスト工程	167
ワイヤボンディング工程(接続工程)	92	第10章 品質管理	171
封止工程	107	第11章 環境管理	190
樹脂製造方法	110	第12章 安全衛生	210
タイバー切断工程	117	第13章 生産管理	218
リード外装めつき工程	121	第14章 設備要素	222
マーキング工程	132		
端子形成・個片化工程 (シンギュレーション)	136		